

# 信頼性試験結果

## Reliability Test

XC6241 シリーズ

XC6241 Series

パッケージ

Package

DFN1010-4D

RoHS対応品 / RoHS Compliance

ハロゲン&amp;アンチモンフリー / Halogen &amp; Antimony-Free

| No. | 試験項目<br>Test Item                        | 試験条件<br>Test Conditions                                                                                                           |                      | 時間<br>Hours   | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1   | 高温バイアス<br>High Temperature Bias          | 125°C VIN=6.2V                                                                                                                    |                      | 1000          | 0/22                  |
| 2   | 高温保存<br>High Temperature Storage         | 150°C                                                                                                                             |                      | 1000          | 0/22                  |
| 3   | 温度サイクル<br>Temperature Cycle              | -65~150°C 各30分<br>30min each                                                                                                      |                      | 100CYC.       | 0/22                  |
| 4   | プレッシャークーカーバイアス<br>HAST                   | 130°C85%RH $2 \times 10^5$ Pa VIN=6.2V                                                                                            |                      | 100           | 0/22                  |
| 5   | はんだ耐熱<br>Resistance to<br>Soldering Heat | 85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times<br>Moisture Sensitivity Level 1<br>Based on IPC/JEDEC J-STD-020 |                      | -             | 0/11                  |
| 6   | 静電耐圧<br>Electric Static Discharge        | MM                                                                                                                                | R=0Ω C=200pF ±200V   | 3回<br>3 times | 0/5                   |
|     |                                          | HBM                                                                                                                               | R=1500Ω C=100pF ±1kV | 3回<br>3 times | 0/5                   |
|     |                                          | CDM                                                                                                                               | ±500V                | 3回<br>3 times | 0/5                   |
| 7   | ラッチアップ<br>Latch-Up                       | R=0Ω C=200pF ±100V                                                                                                                |                      | 1回<br>1 time  | 0/5                   |
|     |                                          | ±50mA                                                                                                                             |                      | 1回<br>1 time  | 0/5                   |

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

| No. | 試験項目<br>Test Item                | 試験条件<br>Test Conditions                                                                            | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 接合強度試験<br>Adhesive Strength Test | PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403)<br>apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec. | 0/5                   |
| 2   | 基板反り試験<br>Bending Test           | たわみ量 5mm 5±1s 1回 (EIAJ ED4702)<br>Strain 5mm 5±1s 1time (EIAJ ED4702)                              | 0/5                   |
| 3   | はんだ付け性<br>Solderability          | 230°C10秒 (プロファイル昇温法)<br>230°C 10s (Temperature profile method )                                    | 0/11                  |